

东莞回收MPS芯源IC芯片

产品名称	东莞回收MPS芯源IC芯片
公司名称	深圳市东城电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	全国各地都可回收
联系电话	158****7035 158****7035

产品详情

3、COB (chip on board)

板上芯片封装，是裸芯片贴装技术之一，半导体芯片交接贴装在印刷线路板上，芯片与基板的电气连接用引线缝合方法实现，并用树脂覆盖以确保可靠性。虽然COB是简单的裸芯片贴装技术，但它的封装密度远不如TAB和倒片焊技术。

DIP (dual in-line package)

Si2312CDS-T1-GE3

SI2307CDS-T1-GE3

Si2305CDS-T1-GE3

Si2303CDS-T1-GE3

SI2303CDS-T1-E3

HMC481MP86E

MP2130DG-C423-LF-Z

MSA-0486-TR1G

NTMFS4119NT1G

NJM4580CG-TE2

NTMFS4C09NAT1G

NTV1215MC

IRFH7936TRPBF

TLV61220DBVR

TLV803SDBZR

TPS3808G01DBVR

TPS563201DDCR

TLV70233DBVR

MP24894GJ-Z

OPA333AIDCKR

INA199A3DCKR

LM2904VQDRQ1

LM258ADR

LM224ADR

TLV3011AIDCKT

TS27M4CDT

NCV20072DR2G

TPS79625DCQR

TPS79601DCQR

REG1117A-2.5

UPC24M06AHF-AZ

ADP3339AKCZ-3-RL7

LM2937IMPX-12/NOPB

TPS64203DBVT

TL1963A-18DCQR

INA2180A1IDGKR

TLV62569PDDCR

TPS2546RTER

ACFM-2113-TR1

TPS79901QDRVRQ1

MP1601CGTF-Z

MP1658GTF-Z

MP1662GTF-Z

TCA9535RTWR

TXS0108ERGYR

BQ25619RTWR

DRV8835DSSR

TPS54335ADDAR

TPS7B4254QDDARQ1

TPS7A1601QDGNRQ1

TPS25944LRVCR

MMA8453QR1